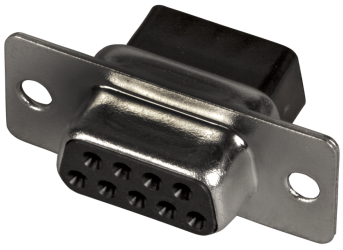
DATENBLATT

DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09



Beschreibung

Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	Crimp
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	rund
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 – 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
34601.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09	9	E-DFCR/09	50 Stück pro Blister	2
34602.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15	15	E-DFCR/15	50 Stück pro Blister	2
34605.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/50	50	E-DFCR/50	50 Stück pro Blister	3
34601.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09	9	E-DFCR/09	50 Stück pro Blister	2
34602.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15	15	E-DFCR/15	50 Stück pro Blister	2
34603.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/25	25	E-DFCR/25	50 Stück pro Blister	2
34604.1V2	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/37	37	E-DFCR/37	40 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de